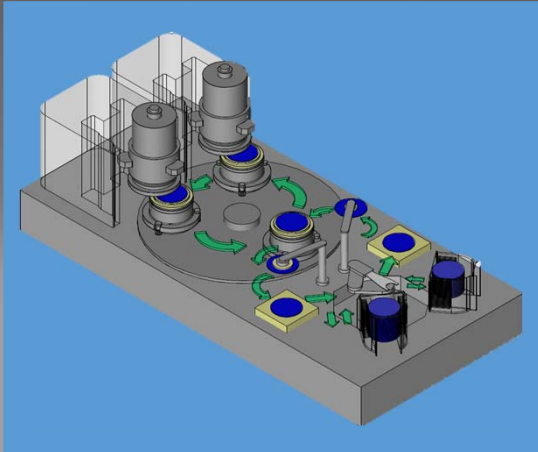


# 全自動平面研削装置 SGM-9100

SiC、GaN、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

化合物半導体ウエハ専用グラインダー



## ・全自動研削システム

CtoC仕様で研削、リンス洗浄、乾燥までを自動で行います。

## ・二頭式砥石軸受け

砥石軸受けを2軸搭載  
粗研削、仕上げ研削を同時に行います。

## ・化合物半導体ウエハ研削に特化した機構

長年培ってきたノウハウと機構を全て取り入れました。  
「硬い」「脆い」「薄い」ウエハを効率よく研削します。

## ・揺動機構

砥石軸受けが前後に揺動しながら研削します。  
加工変質層が浅く、ダメージの少ない研削を可能にしました。

## ・ターンテーブル

ターンテーブル上に3つのチャックを配置することで、効率的なハンドリングと高スループットを実現します。

## SHUWA INDUSTRY COMPANY LIMITED

2-32-16 Takenotsuka, Adachi-ku, Tokyo 121-0813 Japan  
TEL: +81-3-3883-6022 FAX: +81-3-3883-6236  
<http://shuwaind.com>

## 仕様

対応ウエハサイズ	Φ4in～Φ8in
砥石軸数	2
チャック数	3
砥石径	Φ300mm
砥石軸モーター	11kW
砥石軸回転数	3,000rpm(MAX)
ワーク軸回転数	600rpm(MAX)
ワークチャック直径	Φ4inch～Φ8inch ユニバーサルチャック
厚さ計測機器	インプロセス接触式タイプ (オプション: 非接触レーザータイプ)
装置重量	7,500kg
装置寸法	W:1,400mm
	D:3,400mm
	H:1,860mm